Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технический колледж»

# ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

РАССМОТРЕНА на заседании педагогического совета протокол от 30.06.2020 № 11



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности

# ОСНОВЫ ХАЙТЕК

# ХАЙТЕК-Д

Срок реализации программы – 72 часа
Возраст обучающихся первого года обучения: 12-16 лет
Уровень программы (стартовый)

Разработчик: педагог дополнительного образования С.В. Летуновский

# Структура дополнительной общеразвивающей программы

1. Комплекс основных	характеристик	программы
----------------------	---------------	-----------

1.1 Пояснительная записка	стр. 3
1.2 Цель и задачи программы	стр. 4
1.3 Планируемые результаты освоения программы	стр. 8
1.4 Содержание программы	стр. 12
2. Комплекс организационно-педагогических условий.	arm 17
2.1. Календарный учебный график	стр. 17
2.2.Условия реализации программы	стр. 22
2.3. Формы аттестации и критерии диагностики	стр. 23
ICOK HATANOTYNI I	vrn 25

### 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### Направленность программы

Современный период развития общества характеризуется масштабными изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных требований к образованию, предполагающими его ориентацию не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, а также овладение метапредметными компетенциями. Большими возможностями в развитии личностных ресурсов школьников обладает подготовка в области высоких технологий.

Водный модуль по направлению «Хайтекквантум» относится к программам технической направленности и предусматривает развитие творческих способностей детей, формирование начальных технических ЗУНов, а также овладение «soft» и «hard» компетенциями.

### Нормативно-правовое обеспечение программы.

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах:

Программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- 1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ № 273),
- 2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- 3. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726
- 4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. <u>Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ.</u>
- 5. СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

6. Письмо Минобрнауки России от 28 апреля 2017 г. № ВК — 1232/09 «О направлении методических рекомендаций» вместе с (Методическими рекомендациями по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей»).

7. Устав ГОБПОУ «ДТК».

8. Положение о детском технопарке «Кванториум».

Уровень освоения программы: базовый

Направленность (профиль) программы – техническая

### Актуальность программы

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на технически грамотных специалистов в области высоких технологий, максимальной эффективностью развития технических навыков со школьного возраста; передачей сложного технического материала в простой доступной форме; реализацией проектной деятельности школьниками на базе современного оборудования; реализацией личностных потребностей и жизненных планов, а также повышенным интересом детей школьного возраста к высоким технологиям.

Использование современных педагогических технологий, методов и приемов; различных техник и способов работы; современного оборудования, позволяющего исследовать, создавать и моделировать различные объекты и системы из области хайтек производства обеспечивает новизну программы.

### Отличительные особенности программы

Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней уделяется большое внимание практической деятельности учащихся. Программа основана на принципах развивающего обучения, способствует повышению качества обучения, формированию алгоритмического стиля мышления и усилению мотивации к обучению.

### Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она отвечает потребностям общества И образовательным стандартам формировании компетентной, творческой личности. Программа носит сбалансированный характер и направлена на развитие научно-исследовательской культуры обучающихся.

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения.

### 1.2. Цель программы

Целью программы является развитие инженерного и изобретательского мышления детей, навыков командного взаимодействия, моделирования, прототипирования, программирования, освоения передовых технологий в области конструирования, мехатроники, электроники, компьютерных технологий.

Задачи программы:

### Обучающие:

- формирование знаний обучающихся об истории развития отечественной и мировой техники, ее создателях, о различных направлениях изучения высокотехнологичных систем, электроники, технологий искусственного интеллекта;
- изучение принципов работы современных производственных станков, состояние и перспективы цифрового производства в настоящее время;
- формирование умения ориентироваться на идеальный конечный результат;
- обучение владению технической терминологией, технической грамотности;
- формирование умения пользоваться технической литературой;
- формирование целостной научной картины мира;

• изучение приемов и технологий разработки простейших алгоритмов и систем управления, машинного обучения, технических устройств и объектов управления.

#### Развивающие:

- развитие воли, терпения, самоконтроля, внимания, памяти, фантазии;
- развитие способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;
- стимулирование познавательной активности обучающихся посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности.

#### Воспитательные:

- формирование организаторских и лидерских качеств;
- воспитание ответственности, самоорганизации, дисциплинированности;
- формирование чувства коллективизма и взаимопомощи;
- воспитание уважения к труду, трудолюбия;
- воспитание чувства патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники.

### Возраст учащихся, которым адресована программа

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся школьного возраста 12-18 лет (6-11 классы).

### Методы образовательной деятельности

При проведении занятий традиционно используются следующие методы:

- объяснительно-иллюстрационный метод обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах;
- эвристический метод обучение, ставящее целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания;

- метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до обучающихся сложный материал;
- метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях;
- исследовательский метод обучения, дающий обучающимся возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться определенных результатов;
- метод проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и перейти на новую ступень обучения;
  - закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;
  - диалоговый и дискуссионный;
  - игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения);
  - соревнования и конкурсы;
  - создание творческих работ.

# 1.3Планируемые результаты освоения программы

Материал программы подобран с учетом формирования определенных компетенций (soft skills «гибких навыков» и hard skills «жёстких навыков»).

«Гибкие навыки» (soft skills) – комплекс неспециализированных, важных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность, являются сквозными, однако не связаны с конкретной предметной областью (Laura H. Lippman, Renee Ryberg, 2015)

«Жёсткие навыки» (hard skills) – профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить (Биккулова О., 2017).

Результатом освоения базового уровня является освоение общедоступной и универсальной информации, имеющей минимальную сложность, будь то идеология «Кванториума» (цели и задачи), представление о возможностях квантумов и оборудования, межквантумное взаимодействие, формирование и

развитие творческих способностей, стимулирование «генерации идей», мотивация обучающихся к познанию, техническому творчеству, трудовой деятельности и формирование «гибких навыков» (soft skills):

- инженерное и изобретательское мышление; креативность;
- критическое мышление;
- умение искать и анализировать информацию (data scouting); умение принимать решения;
  - умение защищать свою точку зрения; коммуникативность;
  - командная работа;
  - умение презентовать публичное выступление; управление временем;
  - эмоциональный интеллект.

### Личностные результаты

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению современных технологий;
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
- инициатива и ответственность за результаты обучения, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей;
- воспитание ответственного отношения к труду;

### Метапредметные результаты:

- понимать принципы работы современных автоматизированных систем цифрового производства;
- уметь анализировать процессы обработки материалов;

- уметь выявлять и фиксировать проблемные стороны в процессе обработки материала на станке с ЧПУ;
- уметь формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы;
- уметь разбивать задачу на этапы её выполнения;
- уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности
   умение ставить цели и планировать личную учебную деятельность,
   оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений;
- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, представленной в различной знаковой форме в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.;
- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.

### Предметные результаты:

- *ценностно-ориентационная сфера* сформированность представлений о принципах современного цифрового производства, как важнейшем элементе технического прогресса; понимать взаимосвязь между потребностями пользователей и свойствами проектируемых предметов и процессов;
  - познавательная сфера формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни;
  - *трудовая сфера* владение навыками работы различными инструментами в процессе изготовления моделей, прототипирования, а также основы работы с современным компьютерным оборудованием.

По итогам вводного модуля «Основы хайтек», обучающиеся <u>должны знать:</u>

- правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, организовывать рабочее место;
- оборудование и инструменты, используемые в области хайтек творчества;
- основные принципы работы на станках с ЧПУ;
- основные направления развития современного цифрового производства;
- основные сферы применения робототехники, мехатроники и электроники в задачах цифрового производства;
- основные принципы работы электронных схем и систем управления объектами;
- основы языка программирования, в том числе и графические языки программирования;

### должны уметь:

- соблюдать технику безопасности;
- разрабатывать простейшие системы с использованием электронных компонентов и механических элементов;
- разрабатывать простейшие алгоритмы и системы управления станками с ЧПУ;
- разбивать задачи на подзадачи;
- работать в команде;
- проводить мозговой штурм;
- применять логическое и аналитическое мышление при решении задач.

# 1.4. Содержание программы

<b>№</b>	Название	Количест	Форма ат-		
п/п	раздела\темы	Всего	Теория	Практика	тестации/ контроля
1	Введение в образовательную программу, техника безопасности	2	2		опрос
2		20	0	30	
2.1	Конструирование Современные системы цифрового производства	<b>38</b> 2	2	30	тест/опрос
2.2	Занятие на командообразование	2	1	1	игра
2.3	Основные компоненты станков с ЧПУ	4	1	3	тест/опрос
2.4	Основы работы с ручным инструментом	4	1	3	тест/опрос/ демонстрация
2.5	Конструирование простых механизмов	6		6	меха- низм/кон- струкция
2.6	Система лазерного станка с ЧПУ	6	1	5	тест/опрос
2.7	Система фрезерного станка с ЧПУ	8	1	7	тест/опрос
2.8	Моделирование	6	1	5	модель
3	Программирование	30	8	22	
3.1	Обзор ПО. Среда программирования ArtCam	2	1	1	опрос
3.2	Алгоритмы управления станком с ЧПУ G-коды	2	1	1	программа
3.3	Циклы и спецоперации в G-кодах	2	1	1	программа
3.4	Основы теории резания, выбор инструмента и режимов его работы	2	1	1	опрос
3.5	Основы теории энергетического резания (лазерная и плазменная резка)	2	1	1	тест/опрос
3.6	Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ	10	2	8	тест/опрос
3.7	Операции с данными	4	1	3	программа
3.8	Разработка модели	4		4	модель

3.9	Программирование	2		2	программа
	модели				
4.	Подготовка и	2		2	защита
	презентация проекта				проекта
	ИТОГО	72	18	54	

# 1.4.1 Введение в образовательную программу, техника безопасности - 2

<u>Теория.</u> Значение высоких технологий в жизни человека. Что такое техническое моделирование, цифровое производство, электроника, мехатроника. Задачи и план работы учебной группы. Демонстрация готовых изделий. Правила поведения на занятиях и во время перерыва. Инструктаж по технике безопасности.

### 1.4.2. Конструирование - 38 часов

<u>Тема 1. Современные системы цифрового производства (2 ч):</u>

Теория: История систем цифрового производства за рубежом и в России. Основные направления современного цифрового производства. Хайтек в промышленности. Промышленная робототехника

Практика: Демонстрация работы хайтек оборудования.

<u>Тема 2. Занятие на командообразование (2 ч):</u>

Теория: Что такое команда, плюсы и минусы, способы работы в команде.

Практика: Игры на знакомство и командообразование. Работа в команде. Работа по технологии SCRUM.

<u>Тема 3. Основные компоненты (4 ч):</u>

Теория: Основные принципы работы электронных систем управления станком с ЧПУ. Перечень деталей, название узлов и деталей, Принципы их работы.

Практика: Знакомство со станком с ЧПУ. Датчики, сервоприводы, микрокомпьютеры и микроконтроллеры.

Тема 4. Основы работы с ручным инструментом (4 ч):

Теория: Механический и электроинструмент. Устройство и принцип работы. Техника безопасности.

Практика: Основы работы механическим инструментом. Основы работы с электроинструментом.

<u>Тема 5. Конструирование простых механизмов (6 ч):</u>

Теория: Знакомство со способами изготовления дополнительного инструмента – оснастки. Виды оснасток.

Практика: Изготовление оснастки по черетежу.

<u>Тема 6. Система лазерного станка с ЧПУ (6 ч):</u>

Теория: Знакомство с шаговыми двигателями и сервоприводами. Знакомство с системами и узлами лазерного гравера. Принципы работы и настройка станка.

Практика: Работа на лазерном гравере, изготовление тестовой детали.

<u>Тема 7, Система фрезерного станка с ЧПУ (8 ч):</u>

Теория: Знакомство с понятием фрезерной обработки материала. Устройство и принцип работы фрезерного стенка с ЧПУ. Изучение узлов компоненто фрезерного станка.

Практика: Настройка станка, изготовление тестовой детали.

Тема 8. Моделирование (6 ч):

Теория: Основы 3D проектирования, CAD системы.

Практика: Моделирование в системах Blender, SolidWorks, Компас.

### 1.4.3 Программирование - 32 часа

<u>Тема 1. Обзор ПО. Среда программирования ArtCam(2 ч):</u>

Теория: Визуальные системы САD/САМ проектировании.

Практика: Знакомство с программным обеспечением по созданию управляющих программ для станков с ЧПУ.

<u>Тема 2. Алгоритм управления станком G-коды(2 ч):</u>

Теория: Знакомство с понятием алгоритма. Изучение основных свойств алгоритма. Знакомство с видами алгоритмов.

Практика: Создание простых программ в G-кодах.

<u>Тема 3. Циклы и спецоперации в G-кодах(2 ч):</u>

Теория: Блок кодов «Цикл». Знакомство с понятием цикла. Циклы в программировании, варианты их организации.

Практика: Программирование с цикличными условиями.

<u>Тема 4.Основы теории резания. Выбор инструмент аи режимов его работы</u> (2 ч):

Теория: Принципы механической обработки материала резанием. Изучение режимов. Виды резов. Основные параметры и их выбор для различных материалов.

Практика: Изготовление тестовой детали. Самостоятельный расчет режимов работы инструмента.

<u>Тема 5. Основы теории энергетического резания (лазерная и плазменная резка)(2 ч):</u>

Теория: Знакомство с понятием энергетической обработки материала. Основы лазерной и плазменной технологии обработки материала.

Практика: Настройка режимов работы лазерного гравера. Изготовление тестовой детали.

<u>Тема 6. Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ (10 ч);</u>

Теория: Понятие пост-транслятора. Особенности написания управляющих программ для разных станков с ЧПУ.

Практика: Изучение пост-трансляторов на прмере системы ArtCam *Тема 7. Операции с данными (4 ч):* 

Теория: Изучение программных блоков, необходимых для выполнения различных операций над числовыми, логическими и текстовыми данными. Знакомство с функцией регистрации данных в режиме реального времени.

Практика: Создание тестовой программы.

<u>Тема 8. Разработка модели (4 ч):</u>

Теория: Основы редактирования существующих 3D моделей.

Практика: Конструирование собственной модели или доработка предыдущих вариантов, на основе изученного материала. Обсуждение элементов моделей. Сравнение моделей

# <u>Тема 9. Программирование модели (2 ч):</u>

Теория: Полный цикл разработки управляющей программы

Практика: Программирование собственной модели, разработка и запись одного или нескольких вариантов управляющего алгоритма. Испытание модели. Обсуждение возможных неисправностей. Отладка программы.

# 1.4.4 Подготовка и презентация проекта -2ч

Подготовка презентации проекта. Презентация работы управляющих программ на симуляторах станков с ЧПУ и на реальных станках. Изготовление деталей. Подведение итогов.

# Объем программы

Срок реализации программы 72 часа (4 месяца, 72 часа 2 раза в неделю по 2 часа). В основе образовательного процесса лежит проектный подход.

# Режим обучения

Занятия проводятся - 2 раза в неделю по 2 академических часа с десятиминутным перерывом, что определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан- ПиН 2.4.4.3172-14.

# 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 2.1 Календарно учебный график – сделать

<b>№</b> п\п	Мес яц	Чис ло	Время провед ения заняти я	Фор ма занят ия	Кол-во часов	Тема занятия	Место проведени я	Форма контроля
1					2	Введение в образовательную программу, техника безопасности	Лаборато рия Хайтек	опрос
2					2	Современные системы цифрового производства	Лаборато рия Хайтек	тест/опр
3					2	Занятие на командообразование	Лаборато рия Хайтек	игра
4					2	Основные компоненты станков с ЧПУ(лазерный гравер)	Лаборато рия Хайтек	TecT/onp oc
5					2	Основные компоненты станков с ЧПУ(фрезерный станок)	Лаборато рия Хайтек	TecT/onp oc
6					2	Основы работы с ручным инструментом(инструме нт для грубой обработки)	Лаборато рия Хайтек	тест/опр ос/ демонстр ация
7					2	Основы работы с ручным инструментом(инструме нт для тонкой обработки)	Лаборато рия Хайтек	тест/опр ос/демон страция
8					2	Конструирование простых механизмов	Лаборато рия Хайтек	меха- низм/кон - струкция
9					2	Конструирование простых механизмов	Лаборато рия Хайтек	меха- низм/кон - струкция

10	2	Конструирование простых механизмов	Лаборато рия Хайтек	меха- низм/кон - струкция
11	2	Система лазерного станка с ЧПУ(Механика станка)	Лаборато рия Хайтек	тест/опр
12	2	Система лазерного станка с ЧПУ(Электрика станка)	Лаборато рия Хайтек	тест/опр
13	2	Система лазерного станка с ЧПУ(ЭВМ станка)	Лаборато рия Хайтек	тест/опр
14	2	Система фрезерного станка с ЧПУ(Механика станка)	Лаборато рия Хайтек	тест/опр
15	2	Система фрезерного станка с ЧПУ(Электрика станка)	Лаборато рия Хайтек	тест/опр
16	2	Система фрезерного станка с ЧПУ(ЭВМ станка)	Лаборато рия Хайтек	тест/опр
17	2	Система фрезерного станка с ЧПУ(Инструмент станка)	Лаборато рия Хайтек	тест/опр
18	2	Моделирование (Базовые тела)	Лаборато рия Хайтек	модель
19	2	Моделирование (Тела вращения)	Лаборато рия Хайтек	модель
20	2	Моделирование (Тела выдавливания и вырезы)	Лаборато рия Хайтек	модель
21	2	Обзор ПО. Среда программирования ArtCam	Лаборато рия Хайтек	опрос
22	2	Алгоритмы управления станком с ЧПУ G-коды	Лаборато рия Хайтек	программ а

24   2 Основы теории резания, выбор инструмента и режимов его работы   Даборато рия Хайтек     25   2 Основы теории резания (резания (р	рос
24   2 Основы теории резания, выбор инструмента и режимов его работы   Даборато рия Хайтек его работы   Даборато опрезания (назерная и плазменная резка)   Даборато резания (назерная и плазменная резка)   Даборато прогосновы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Даборато рия Хайтек   Даборато рия Даборато прогосновы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Даборато рия Хайтек   Даборато рия Даборато рия Хайтек   Даборато рия Даборато рия Даборато рия Даборато рия Хайтек   Даборато рия Даборато прогосновы разработки управляющих программ Дат станка с ЧПУ Даборато прогосновы разработки управляющих программ Дат станка с ЧПУ Даборато прогосновы разработки управляющих программ Дат станка с ЧПУ Даборато прогосновы разработки управляющих программ Дат станка с ЧПУ Даборато прогосновы разработки управляющих программ Дат станка с ЧПУ Даборато прогосновы разработки управляющих программ Дат станка с ЧПУ Даборато прогосновы разработки управляющих программ Дат станка с ЧПУ Даборато прогосновы разработки управляющих программ Дат станка с ЧПУ Даборато прогосновы разработки управляющих програм Даборато прогосновы разработки управляющих програм Даборат прогосновы разработки управляющих програм Даборат прогосновы разработки управляющих програм Даборат прогосновы разработки управляющих прогосновы разработки управляющих	рос
24   2 Основы теории резания, выбор инструмента и режимов его работы его работы оприя унатек его работы опредения (лазерная и плазменная резка)   1 Лаборато резания (лазерная и плазменная резка)   2 Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   2 Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   1 Лаборато рия для станка с ЧПУ   1 Лаборато программ для станка с ЧПУ   1 Лаборато программ для станка с ЧПУ   1 Лаборато рия для станка с ЧПУ   1 Лаборато программ д	рос
резания, выбор инструмента и режимов его работы   Даборато оп энергетического резания (лазерная и плазменная резка)   Даборато резания (лазерная и плазменная резка)   Даборато резания (лазерная и плазменная резка)   Даборато рия Хайтек и плазменная резка)   Даборато прогосновы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Даборато прогосновы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Даборато прогосновы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Даборато прогосновы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Даборато рия Хайтек   Дая станка с ЧПУ   Даборато прогосновы разработки рия Хайтек   Дая станка с ЧПУ   Даборато прогосновы разработки рия Хайтек   Дая станка с ЧПУ   Даборато прогосновы разработки рия Хайтек   Дая станка с ЧПУ   Даборато прогосновы разработки рия Хайтек   Даборато прогосновы	рос
резания, выбор инструмента и режимов его работы   Даборато оп энергетического резания (лазерная и плазменная резка)   Даборато резания (лазерная и плазменная резка)   Даборато рия Хайтек   Даборато резания (резания программ для станка с чпу управляющих прог	рос
25	грамм
25   2   Основы теории энергетического резания (лазерная и плазменная резка)   Опост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Остовы разработки управляющих	грамм
2	грамм
Знергетического резания (лазерная и плазменная резка)   Даборато прогосновы разработки управляющих программ для станка с чПУ   Даборато рия дайтек	_
26	_
2   Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек     27   2   Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек     28   2   Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек     29   2   Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек     30   2   Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек     31   2   Операции с данными (редактировани рия рия данными (редактировани рия рия данными (редактировани рия рия данными (редактировани рия рия данными (редактировани рия даборато рия рия данными (редактировани рия даборато рия даборато рия рия данными (редактировани рия рия рия даборато рия рия данными (редактировани рия рия рия рия данными (редактировани рия даборато рия	_
Основы разработки управляющих программ Для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия   Даборато рия   Дабор	_
Управляющих программ для станка с ЧПУ	a
ДЛЯ СТАНКА С ЧПУ   ДАБОРАТО   ПРОПОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ   УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ   ДЛЯ СТАНКА С ЧПУ   ДАБОРАТО   РИЯ   ХАЙТЕК   ДЛЯ СТАНКА С ЧПУ   ДАБОРАТО   РИЯ   РИЯ	
2   Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек     2	
Основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия управляющих программ управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия управляющих программ управляющих программ управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия управляющих программ управляющих программ управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия данными (редактировани рия рия данными (редактировани рия рия данными (редактировани рия данными программ рия данными (редактировани рия данными средактировани рия данными (редактировани рия данными средактировани риз данными рия данными средактировани рия данными средактировани рия данными	
Управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия   Даборато рия   Д	рамм
Для станка с ЧПУ   Лаборато прогосновы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия для станка с ЧПУ   Лаборато рия для станка с ЧПУ   Лаборато рия данными (редактировани рия рия рия рия данными (редактировани рия рия рия рия рия рия рия рия рия ри	a
2   Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   29   2   Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   30   2   Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато рия   Данными (редактировани рия рия рия данными (редактировани рия рия рия рия рия рия рия рия рия ри	
основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ  2 Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ  30 2 Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ  30 2 Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ  31 2 Операции с данными (редактировани рия	
Управляющих программ для станка с ЧПУ   Даборато основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Даборато основы разработки для станка с ЧПУ   Даборато основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Даборато основы разработки управляющих программ для станка с ЧПУ   Даборато данными (редактировани рия данными (редактировани рия данными (редактировани рия для станка с ЧПУ рия данными (редактировани рия данными (редактировани рия данными (редактировани рия данными станка с ЧПУ рия данными (редактировани рия данными станка с ЧПУ рия даборато рия данными станка с ЧПУ рия данными станка с ЧПУ рия даборато рия данными станка с ЧПУ рия данными с ч	рамм
Для станка с ЧПУ   Лаборато протосновы разработки рия	a
2 Пост-трансляторы и основы разработки управляющих программ Дайтек   Для станка с ЧПУ   Лаборато основы разработки управляющих программ управляющих программ управляющих программ Дайтек   Для станка с ЧПУ   Хайтек   Для станка с ЧПУ   Заборато данными (редактировани рия рия рия рия рия рия рия рия рия ри	
основы разработки рия Хайтек  для станка с ЧПУ  2 Пост-трансляторы и основы разработки рия управляющих программ управляющих программ Хайтек  31 2 Операции с данными (редактировани рия	
управляющих программ для станка с ЧПУ  2 Пост-трансляторы и основы разработки рия управляющих программ для станка с ЧПУ  31 2 Операции с данными (редактировани рия	рамм
Для станка с ЧПУ   Даборато протосновы разработки рия управляющих программ для станка с ЧПУ   З1   2   Операции с данными (редактировани рия рия рия рия рия рия данными (редактировани рия рия рия рия рия рия рия рия рия ри	a
2 Пост-трансляторы и основы разработки рия Хайтек   Для станка с ЧПУ   Операции с данными (редактировани рия рия рия рия рия рия рия рия рия ри	
основы разработки рия Хайтек управляющих программ Дайтек для станка с ЧПУ  2 Операции с Лаборато данными (редактировани рия	
управляющих программ Дайтек для станка с ЧПУ  2 Операции с Лаборато данными (редактировани рия	рамм
для станка с ЧПУ  31 2 Операции с Лаборато прог данными (редактировани рия	a
31 2 Операции с Лаборато прог данными (редактировани рия	
данными (редактировани рия	
	-
	a
постпроцессоров)   32   2   Операции с   Лаборато прог	
	рамм
данными (редактировани рия е программ в процессе Хайтек	a
исполнения)	
	цель
	1C11D
рия Хайтек	
Aanter	
34 2 Разработка модели Лаборато мод	
рия	 .е.ль
Хайтек	цель
Tanter	іель
35 2 Программирование Лаборато прог	<u>цель</u>
Хайтек	цель грамм а
	грамм

36			2	Подготовка и	Лаборато	защита
				презентация проекта	рия	проекта
					Хайтек	

# 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 4.1 Методическое обеспечение программы Педагогические технологии

В процессе обучения по программе используются разнообразные педагогические технологии:

- технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие личности, на основе активно-деятельного способа обучения, учитывающие закономерности развития и особенности индивидуума;
- технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта;
- технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей;
- технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство в отношениях педагога и обучающегося;
- проектные технологии достижение цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом;
- компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, исследовательские умения, коммуникативные способности.

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их элементов.

В ходе работы целесообразно использовать следующие методы, приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу.

№	Формы	Методы и при-	Возможный ди-	Формы кон-
	организации	емы	дактический	троля
			материал	
1	Эвристическая	- эвристический	Презентация,	Фронтальный и
	беседа или	метод;	плакат, кар-	индивидуаль-
	лекция	-метод устного	точки, видео	ный устный
		изложения, поз-		опрос
		воляющий в до-		
		ступной форме		
		донести до обу-		
		чающихся		
		сложный мате-		
		риал;		
2	Игра	- практический	Правила игры	Рефлексивный

		метод; - игровые ме- тоды;	Карточки с опи- санием ролей или заданий Атрибутика игры	самоанализ; контроль и са- мооценка обу- чающихся
3	Лабораторно- практическая работа	- репродуктив- ный; - частично-по- исковый	Видео, презентация, плакаты, карточки с описанием хода работы, схемы сборки и т.д.	Взаимооценка обучающимися работ друг друга
4	Проект	- исследователь- ский метод; - частично-по- исковый (в за- висимости от уровня подго- товки детей)	Презентация, видео, памятка работы над проектом	Защита проекта, участие в научной выставке
5	Исследование	-исследователь- ский метод	Презентация, видео, описание хода исследования и т.д.	Конференция

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в течение всего срока реализации программы. Это помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. Для оценки эффективности образовательной программы выбраны следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, образного, логического и технического мышления.

# Учебно-методические средства обучения:

- специализированная литература по цифровому производству, подборка журналов;
  - наборы технической документации к применяемому оборудованию;
  - образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом;
  - плакаты, фото и видеоматериалы;
- учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие дидактический, информационный, справочный материалы на различных носителях, компьютерное и видео оборудование.

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы и системы используемых Программ, Интернет, рабочие тетради обучающихся.

# 2.2. Материально-технические условия реализации программы

Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная мебелью на 14 посадочных мест, компьютерной техникой, не менее 1 ПК на 1 ученика.

Рекомендуемое учебное оборудование, рассчитанное на группу из 14 учащи
«Основы Хайтек»
Лазерный гравер Trotec Speedy- $100R$ C60 ( CO2 лазер 60 Bt) + система поддува с компрессором (Компрессор для системы поддува +Рама на колесах+Ячеистый стол для резки (ячейка 6,4 мм либо 12,7 мм))
Вращатель для гравировки цилиндрических изделий с конусами Speedy-100R
Atmos Cube
3D принтер Nobel 1.0 XYZprinting (XYZ)
3D принтер Raise3D Pro2
3D принтер Hercules Strong DUO
Ручной 3D сканер EinScan Pro 2X
3D принтер Wanhao Duplicator 6 Plus
Фрезерный станок ROLAND MODELA MDX-50
ZS-FS - 4 IIIT ZS-SCR - 3 IIIT ZS-SC - 3 IIIT
ZC-20-30, 3мм цанга для SRM-20
ZCL-50 (поворотная ось к MDX-50)
SRM-20, фрезерный станок Roland серии monoFab
ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ 230 В JET BD-8VS
НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК JET JDP-8BM
Metabo 627154000
Сверлильный станок ДИОЛД СВС-500/50 20010021
СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 400 В JET JDP-15В
Сверлильные тиски WILTON Q75 75x80 мм WI91193RU
Заточной станок TRIOD UTG-25 123020
СТАНОК ЗАТОЧНОЙ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ JET JSSG-10
Точило Bosch GBG 35-15 060127A300
Тиски слесарные 100 мм GV-STM04
Набор ручного механического инструмента
Набор электроинструмента
Набор расходных материалов (фанера, ABS/PLA Пластики, оргстекло)

# 2.3. Формы аттестации и критерии диагностики

- . В процессе обучения организованы следующие виды и формы контроля:
- входной (беседа, практическое задание, тест по технике безопасности);
- текущий (практические задания, формулировка идей, презентация идеи);
- итоговый (презентация проекта).

Способ оценки, как правило, устный. Отмечаются недостатки выполненных работ в лёгкой форме. Основной акцент делается на её достоинства, чтобы не отбить у ребёнка желание обучаться и нацелить на исправление недостатков.

Формы аттестации:

- практическая творческая работа;
- публичное выступление;
- выставка-презентация;

### Критерии диагностики

Параметры	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
диагностики			
	Плохо владеет	Владеет основными	Свободно владеет
	понятиями по	понятиями по	понятиями по
	пройденным темам, не	пройденным темам,	пройденным темам,
Теоретическая	может объяснить, что	применяет их на	применяет их на
подготовка	виткноп ите	практике. Не всегда	практике, объясняет
	обозначают, не	может объяснить	значение этих понятий.
	применяет их на	значение этих понятий.	
	практике.		
Практическая	Владение инструментом	М	
подготовка	Плохо владеет	Знает правила техники	Хорошо владеет
	инструментом, не	безопасности при	инструментом. Знает
	знает правила техники	работе с инструментом,	правила техники
	безопасности при	соблюдает их. Не	безопасности при работе
	работе с	достаточно уверенно	с инструментом,
	инструментом.	владеет инструментом.	соблюдает их.
	Практические умения и	навыки	
	Не может	Самостоятельно	Самостоятельно
	самостоятельно	выполняет всю работу.	качественно выполняет
	изготовить все детали.	Модель имеет	модель. Умеет
	Детали имеют	несущественные	отрегулировать модель.
	существенные	дефекты.	Может помочь
	дефекты. Не может	Самостоятельно	товарищу.
	самостоятельно	регулирует модель.	
	отрегулировать		
	модель.		

Участие в	На соревнованиях	На соревновании не	На соревнованиях
соревнованиях	плохо выступает или	занял призового места,	занимает призовые
	не выступает вообще.	но попал в первую	места.
		десятку занятых мест.	

### Виды контроля:

- вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;
- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме;
- итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.

### Формы подведения итогов обучения:

- индивидуальная устная/письменная проверка;
- фронтальный опрос, беседа
- контрольные упражнения и тестовые задания;
- предъявление рабочей модели (механизма, конструкции, программы идр.);
- защита проекта;
- межгрупповые соревнования;
- проведение промежуточного и итогового тестирования;
- взаимооценка обучающимися работ друг друга.

Итоговая оценка развития личностных качеств обучающегося производится по трём уровням:

- «высокий»: положительные изменения личностного качества обучающегося в течение обучения признаются как максимально возможные для него;
- «средний»: изменения произошли, но обучающийся потенциально был способен к большему;
  - «низкий»: изменения не замечены.

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки и защиты проекта (в разных формах), анализа посещаемости занятий, активности

участия в программе по формированию общекультурных компетенций, результатам участия в конкурсах, соревнованиях и т.д.

### Список рекомендуемой литературы

- 1. Изобретательство и инженерия Альтшуллер Г. С. Найти идею.
- 2. Введение в теорию решения изобретательских задач. Новосибирск: Наука, 1986 Иванов Г. И.
- Формулы творчества, или Как научиться изобретать: Кн. Для учащихся ст. Классов. М.: Просвещение, 1994.
- 4. Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений: Пер. с англ.- М.:Мир, 1969. John R. Dixon. Design Engineering: Inventiveness, Analysis and Decision Making. McGraw-Hill Book Company. New York. St. Louis. San Francisco. Toronto. London. Sydney. 1966. 5. Альтшуллер Γ. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизн. Стратегия творч. Личности. Мн: Белорусь, 1994. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М: Московский рабочий, 1969. Негодаев И. А. Философия техники: учебн. Пособие. Ростов-на-Дону: Центр ДГТУ, 1997
- 3D моделирование и САПР В.Н. Виноградов, А.Д. Ботвинников, И.С. Вишнепольский «Черчение. Учебник для общеобразовательных учреждений», г.Москва, «Астрель», 2009.
- 7. Аддитивные технологии Уик, Ч. Обработка металлов без снятия стружки /Ч.Уик.—М.: Изд-во «Мир», 1965.—549 с Wohlers T., Wohlers report 39 2014: Additivemanufacturing and 3D-printing state of the industry: Annual worldwide progress report, Wohlers Associates, 2014 Printing for Science, Education and Sustainable Development Э. Кэнесс, К. Фонда, М. Дзеннаро, СС Attribution Non Commercial-Share Alike, 2013

8. Лазерные технологии С. А. Астапчик, В. С. Голубев, А. Г. Маклаков.

Лазерные технологии в машиностроении и металлообработке. —

Белорусская наука. Colin E. Webb, Julian D.C. Jones. Handbook Of Laser

Тесhnology And Applications (Справочник по лазерным технологиям и их применению) book 1.-2 — IOP. Steen Wlliam M. Laser Material Processing. —

nd edition. — Great Britain: Springer-Verlag.

- Вейко В.П., Петров А.А. Опорный конспект лекций по курсу
   «Лазерные технологии». Раздел: Введение в лазерные технологии.— СПб:
   СпбГУ ИТМО, 2009 143 с
- 10. Вейко В.П., Либенсон М.Н., Червяков Г.Г., Яковлев Е.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. М.: Физматлит, 2008.
- 11. Фрезерные технологии Рябов С.А. (2006) Современные фрезерные станки и их оснастка: Учебное пособие Корытный Д.М. (1963)
- 12. Фрезы Современные тенденции развития и основы эффективной эксплуатации обрабатывающих станков с ЧПУ Чуваков А.Б. Нижний Новгород, НГТУ 2013
- Пайка и работа с электронными компонентами Максимихин М. А.
   Пайка металлов в приборостроении. Л.: Центральное бюро технической информации, 1959;

# Список литературы для учащихся

- 1. И.А. Ройтман, Я.В. Владимиров «Черчение. Учебное пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений», г.Смоленск, 2000.
- Герасимов А. А. Самоучитель КОМПАС-3D V9. Трехмерное
   проектирование Страниц: 400; Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7. СПб.: БХВ-Петербург, 2016.- 400 с.
- 3. Компьютерный инжиниринг : учеб. Пособие / А. И. Боровков [и др.]. СПб. : Изд-во Политехн. Ун-та, 2012. 93 с.
- 4. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. М.: ДМК Пресс, 2010. 192 с.